



主要特点

- 频率范围: 2 - 6 GHz
- 插入损耗: 1.5 dB @ 2 GHz & 6 GHz
- 均衡量: 4 dB
- 输入输出回波损耗: 12 dB
- 输入/输出: 50 Ohm 匹配
- 芯片尺寸: 1 × 0.6 × 0.1 mm³

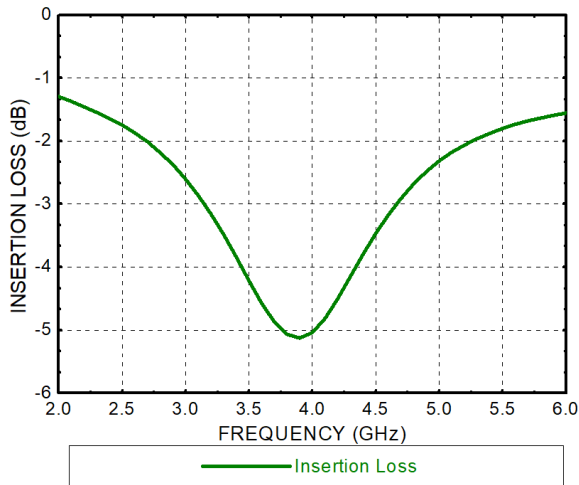
产品简介

HGC130-3 是一种 GaAs MMIC 均衡器芯片, 广泛应用于改善带内波动、均衡幅度特性。该芯片通过背面金属经通孔接地, 输入输出考虑金丝键合影响。推荐用 2 根直径 25μm 金丝键合, 键合线长度 300μm 左右最佳。

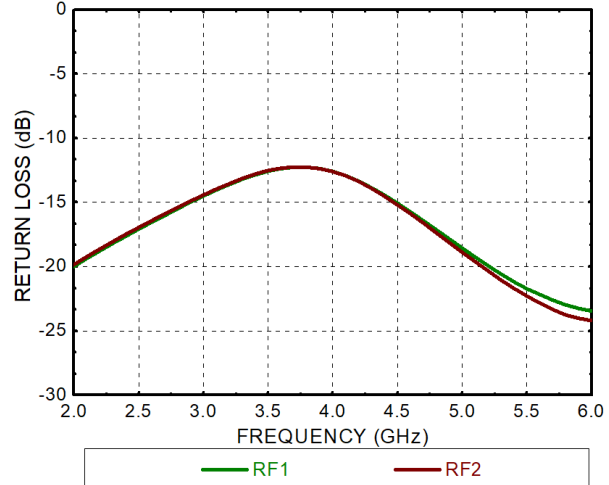
性能指标 (T_A = +25°C)

参数	最小	典型	最大	单位
频率范围	2-6			GHz
插入损耗 @ 2 GHz & 6 GHz		1.5		dB
均衡量		4		dB
回波损耗		12		dB

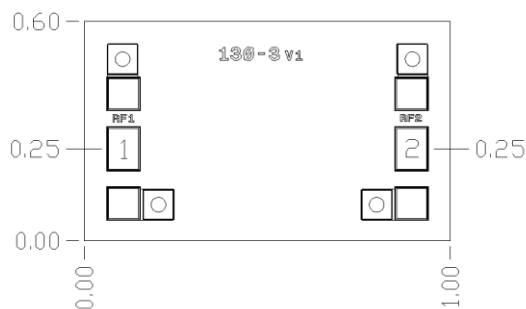
插入损耗



回波损耗



物理参数



焊盘描述

焊盘序号	功能	描述
1, 2	RF1, RF2	该系列焊盘射频端口

极限参数

最大输入功率	+30 dBm
存储温度	-65 ~ +150° C
工作温度	-55 ~ +85° C